

「114 學年度日間部 電子工程系 日間部碩士班課程規劃表」

修正備註條文對照表

修正後條文	現行條文	說明
注意事項： 1.最低畢業學分：30 學分，含必修：_ 9 _，選修_ 21 _學分(本所至少_ 12 _學分，其餘可跨所)。 2.每學期修習學分：下限為 1 學分。 3.「論文」必修 6 學分，俟口試通過後，一次給予 6 學分。 4.表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。 5.本表建立於 115 年_3_月_17_日。	注意事項： 1.最低畢業學分：30 學分，含必修：_ 9 _，選修_ 21 _學分(本所至少_ 18 _學分，其餘可跨所)。 2.每學期修習學分：下限為 1 學分。 3.「論文」必修 6 學分，俟口試通過後，一次給予 6 學分。 4.表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。 5.本表建立於 114 年_2_月_20_日。	1. 修正專業選修學分。



114學年度課程規劃表

電子工程系

日間部碩士班

第一學年(114)						第二學年(115)					
	科目	上學期		下學期			科目	上學期		下學期	
		學分	時數	學分	時數			學分	時數	學分	時數
院 必 修	專題討論	1	2	1	2	院 必 修					
	研究方法與論文寫作	1	2								
	小計	2	4	1	2		小計	0	0	0	0
專 業 必 修						專 業 必 修	論文	3	3	3	3
	小計	0	0	0	0		小計	3	3	3	3
專 業 選 修	AI機器學習語言	3		3		專 業 選 修	ESD佈局設計	3		3	
	數位積體電路佈局設計	3		3			類比積體電路佈局設計	3		3	
	半導體製程整合技術	3		3			半導體封裝技術	3		3	
	積體電路量測技術	3		3			積體電路可靠度分析	3		3	
	半導體元件物理	3		3			相鎖迴路積體電路佈局設計	3		3	
	功率積體電路	3		3			混合積體電路佈局設計	3		3	
	半導體功率元件	3		3			半導體設備機台設計	3		3	
	電磁理論	3		3			系統晶片設計實務	3		3	
	射頻電路設計	3		3			機器視覺實務	3		3	
	微波工程	3		3			射頻積體電路設計	3		3	
	微帶天線設計	3		3			微波電路設計	3		3	
	數位通訊理論	3		3			行動天線設計與量測	3		3	
	Zigbee無線感測網路系統	3		3			個人無線通訊系統	3		3	
	TCL/TK自動佈局設計	3		3			新世代封裝測試技術	3		3	
	AI封裝檢測實務	3		3			人工智慧觸控技術	3		3	

【科目類別】		學分	時數
專業科目	院必修	3	6
	專業必修	6	6
	專業選修	21	21
合計		30	33

【注意事項】

1. 最低畢業學分：30學分，含必修：9，選修21學分(本所至少12學分，其餘可跨所)。
2. 每學期修習學分：下限為1學分。
3. 「論文」必修6學分，俟口試通過後，一次給予6學分。
4. 表列專業選修課程，得依實際情況逕行調整。
5. 本表建立於115年3月17日。

電子工程系
主任張承勛

明新科技大學電子系
課程教學小組



半導體學院
院長陳啟文

MUST Curriculum Planning for Graduate Students for Academic Year 2025-2026,
Institute of Electronic Engineering

1 st year(114)						2 nd year(115)					
	Course	1 st semester		2 nd semester			Course	1 st semester		2 nd semester	
		Cr.	hr.	Cr.	hr.			Cr.	hr.	Cr.	hr.
MUST Core Required Courses	Seminar	1	2	1	2	MUST Core Required Courses					
	Research Methodo and Thesis Writing	1	2								
	Subtotal	2	4	1	2		Subtotal	0	0	0	0
Compulsory Courses						Compulsory Courses	Thesis	3	3	3	3
	Subtotal	0	0	0	0		Subtotal	3	3	3	3
Elective Courses	AI Machine Learning Language	3		3		Elective Courses	ESD Layout Designs	3		3	
	Digital Integrated Circuit Layout Designs	3		3			Analog Integrated Circuit Layout Designs	3		3	
	Semiconductor Manufacturing and Integration Technique	3		3			Semiconductor Assembly Techniques	3		3	
	Integrated Circuits Measurement Techniques	3		3			Integrated circuit reliability analysis	3		3	
	Semiconductor Physics	3		3			PLL Integrated Circuit Layout Desings	3		3	
	Power Integrated Circuits Design	3		3			Mixed Mode Integrated Circuit Designs	3		3	
	Semiconductor Power Discrete Device	3		3			Design of Semiconductor Production Equipments	3		3	
	Electromagnetic Theorv	3		3			System on Chip Design Practice	3		3	
	RF Circuits Design	3		3			Practice of Machine Vision	3		3	
	Microwave Engineering	3		3			RF IC Design	3		3	
	Microstrip Antenna Design	3		3			Microwave Circuits Design	3		3	
	Digital Communication Theory	3		3			Mobile Antenna Design and Measurement	3		3	
	Zigbee Wireless Sensor Networks	3		3			Personal Wireless Communication System	3		3	
	TCL/TK Auto-Layout Designs	3		3			New-era Package and Testing Technology	3		3	
	AI Package and Testing Practices	3		3			AI Touch Technology	3		3	

Cr./hr. =Credit/hour

Remarks:

1. Minimum graduation credits: 30 credits; compulsory credits: 9 credits, electives: 12 credits (elective credits include inter-departmental elective credits).
2. Study credits per semester: the lower limit is 1 credit.
3. All 6 thesis credits will be granted only after passing the oral exam.
4. The elective courses are subject to change if necessary.
5. This form created in 115.3.17.

明新科技大學電子系
課程教學小組

電子工程系 張承勛
主任



半導體學院 陳啟文
院長